

CERASIC®-B常圧焼結SiC

CERASIC-B Pressureless Sintered SiC

シリコンウェーハや液晶基板の大型化に伴い、プロセス材料には軽量、高精度、さらには長期間劣化しないなどの特性が求められています。

コバレント材料の“CERASIC®-B”は軽量、高剛性に加え、熱伝導性、耐摩耗性、耐食性に優れるなど、多くの特徴をもっており弊社の高精度加工技術、接合技術と組み合わせ、高度化するユーザーニーズに対応しています。

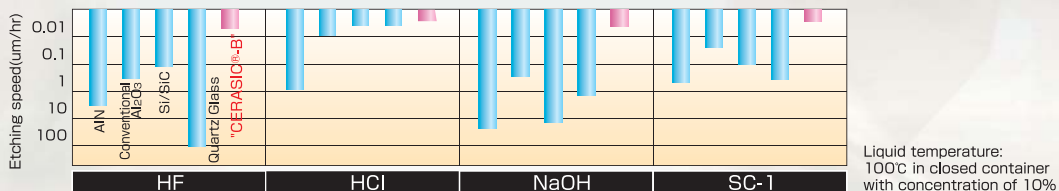
Properties such as light weight, high precision, as well as long-term degradation resistance are required of process materials in accordance with increases in the size of silicon wafers and LCD boards.

CERASIC-B made by Covalent Materials has a number of features including light weight and high rigidity, superior thermal conductivity, wear resistance and corrosion resistance. In combination with Covalent Materials high-precision machining technology, it is adaptable to a large range of user needs.

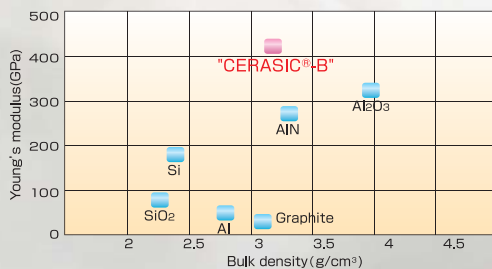
特長 Features

- 最大形状:プレート1300X60mm チューブ φ420X2200mm
Max. size availability: Plate = 1300X60mm, Tube = OD420X2200mm
- 独自の接合技術による中空形状が可能
Hollow shapes are possible with our unique joining technology.
- 精密加工対応可能
Precision machining (Flatness <5μm) can be applied.
- 表面へのCVD-SiCコートも可能
CVD-SiC coating can be applied to the product surface.

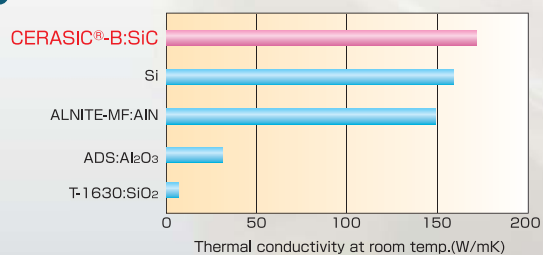
薬液に対する侵食速度比較 Etching rate comparison



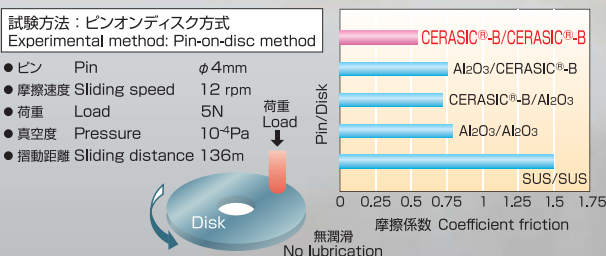
密度・ヤング率比較 Density・Young's modulus



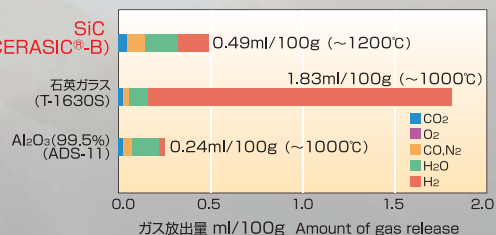
熱伝導率比較 Thermal conductivity



真空中での摩擦特性の比較 Friction characteristics in vacuum



CERASIC®-Bのガス放出特性 CERASIC-B gas release characteristics



COVALENT

コバレントマテリアル株式会社

セラミックス事業本部

東京都品川区大崎1-6-3 日精ビルディング 〒141-0032

Tel:03-5437-8414 Fax:03-5437-7395

www.covalent.co.jp